

融资环境逐步向好 上市房企融资活动升温

记者 张良

2026年以来，上市房企融资活动显著升温。新城发展、中华企业、粤海置地、越秀地产、华发股份等多家企业近日披露融资事宜，筹资规模可观，行业融资环境呈现积极转变。

业内人士表示，在房地产金融政策发力的背景下，房企融资环境持续改善，融资目的聚焦在建项目再投资与债务偿付，核心在于保障项目交付及规避违约风险，与当前防风险政策基调高度契合。

多家房企披露融资进展

2月11日晚，新城发展在港交所发布公告，配售事项及认购事项已分别于2月9日和11日完成，共有1.98亿股股份按每股2.39港元的价格成功配售给不少于六名承配人。公司已收取认购款项净额约4.69亿港元。公司拟将所得款项净额用于公司的未来发展和偿还到期债务及用作一般运营资金。

2月11日，中华企业在中国银行间市场交易商协会官网披露了公司2026年度第一期中票募集说明书。该文件显示，本期债务融资工具的基础发行规模为10亿元，发行金额上限为22亿元，期限3年，募集资金拟全部用于偿还到期债务融资工具。本期债务融资工具

按面值发行，申购利率区间为2.30%至3.20%，发行日期为2026年2月12日，兑付日期为2029年2月13日。

越秀地产和华发股份也公布了新一轮融资。2月10日，越秀地产发布广州市城市建设开发有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告，本期债券发行工作已于2月10日结束，品种一取消发行，品种二发行规模为7亿元，品种二票面利率为2.18%，认购倍数为1.67倍。

2月4日，华发股份公告称，公司拟向控股股东华发集团发行不超过7.13亿股A股股票，发行价格为4.21元/股，募集资金总额预计不超过30亿元。

同策研究院联席院长宋红卫向记者表示，当前房企配股、增发融资具有三大特征：第一，从企业性质看，主要是一些央企、国企背景企业以及具备稳定现金流业务、持有型运营资产的民营企业；第二，拥有强有力的支持，目前增发融资多由控股股东认购；第三，从融资目的看，主要用于在建项目的再投资，核心在于保交房，或者用于未来偿债要求，避免债务违约，与当前防风险的基调一致。

房企融资环境正逐步改善

值得一提的是，华发股份披露的定增预

案是今年上市房企的首单定增案例。

预案显示，华发股份本次向特定对象发行A股股票募集资金总额预计不超过30亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于珠海华发城建国际海岸花园二期项目、绍兴金融活力城项目、成都天府项目、杭州武林御林宸院项目等9个项目。华发股份表示，通过此次定增可以增加公司的所有者权益，降低资产负债率，改善财务结构，减少偿债风险，为后续债务融资提供空间和保障。

国盛证券认为，若本次定增成功实施，将改善华发股份资产负债结构，同时募投项目聚焦核心城市的保交房与高品质住宅建设，助力巩固其在重点区域的市场竞争力。此次大股东的强力支持，有望增强债券投资者的信心，进一步维护和夯实融资渠道。

房企融资环境正逐步改善。2026年1月初，市场有消息称，对已经进入房地产融资协调机制“白名单”的项目，符合一定条件和标准的，可在原贷款银行进行展期，展期期限可延长至5年。

一位民营房企高管向记者表示，一位民营房企高管向记者表示，“白名单”政策仍然在持续帮扶房企，企业可以根据项目的情况与银行友好协商贷款的展期及降息。

研究机构的报告亦有印证。中指研究院2月12日发布的研报显示，2025年，房地产企业债券融资总额为5967.2亿元，同比增长5.6%。从融资结构来看，房地产行业信用债融资3428.7亿元，同比微降0.6%，占比为57.5%；海外债融资161.5亿元，同比增长141%，占比为2.7%；ABS融资2377亿元，同比增长11.2%，占比为39.8%。2025年行业债券平均利率为2.69%，同比下降0.26个百分点。受降息、融资企业结构和产品结构变化等因素影响，行业债券平均融资成本明显下降。

据普睿数智研究中心统计，2026年1月，50家典型房企境内债权融资193.82亿元，环比增长62.4%，同比增长3.1%；境外债权融资20.87亿元，环比减少48.3%，同比增长4.3%。

宋红卫表示，尽管当前融资环境有所改善，但是房地产行业面临的债务压力仍然较大，因此还需要相关部门给予房地产行业合理的融资支持。对于企业而言，应认清楼市已经步入存量阶段的现实，以往过度依赖增量市场的“重资产”模式已难以适应当前的新形势。未来增量市场依赖的不是规模，而是回归单项目盈利模式，不仅要控制杠杆率，也要注重现金流管理，通过高品质项目来迎合市场改善群体的住房需求。

加码高端铜箔 逸豪新材卡位新能源赛道



在逸豪新材生产车间内，工人们正开足马力完成订单

记者 王凯丰

临近春节，在逸豪新材无尘的封闭式生产车间内，一条条自动化生产线正高速运转，工人们熟练地操作着设备，开足马力完成订单。

“公司目前在手订单充足，铜箔产线持续处于满产状态。”逸豪新材总经理刘磊向记者介绍，公司是业内少数实现“铜箔—覆铜板—PCB”全产业链布局的企业，电解铜箔产能位居行业前列。

近年来，随着AI服务器等应用领域的高速发展，铜箔下游需求稳步增长。刘磊表示，随着今年公司1万吨高精度电解铜箔项目落地投产，公司将持续加码高端铜箔产能布局，充分发挥垂直一体化产业链的协同效应，提升高附加值产品的比重，在新能源赛道加速卡位。

技术创新筑牢根基 产品矩阵适配市场需求

“当时全国铜箔企业不超过10家，逸豪新材便是其中之一。”刘磊介绍，成立于2003年的逸豪新材是国内较早开展电子电路铜箔业务的企业，近年来构建起从电解铜箔、铝基覆铜板到印制电路板的全产业链布局，并于2022年9月在创业板上市。

在高端铜箔领域，技术创新是企业核心竞争力的关键。作为行业内为数不多的具有PCB垂直一体化产业链布局的企业，逸豪新材拥有电子电路铜箔、铝基覆铜板和PCB生产核心技术，形成了独特的技术协同优势，为高端铜箔研发生产提供了坚实支撑。

研发投入的持续加码为技术突破提供保障。近年来，公司不断丰富铜箔产品结构，涵盖超薄铜箔、薄铜箔、常规铜箔等多个种类，其中电子电路铜箔产品矩阵持续完善，已形成覆盖9μm至210μm的完整产品体系，产品最大幅宽保持行业领先水平。

在PCB领域，公司已在车载PCB板及MiniLED PCB板领域实现稳定量产，并成功应用于相关终端产品。目前，在巩固现有量产优势的同时，公司正开发强电工控电源领域的厚铜PCB板客户，并持续加大多层PCB板的拓展及工艺技术研发力度，以拓展未来增长空间。

刘磊表示，通过持续的技术积累与市场开拓，逸豪新材已与生益科技、南亚新材、鹏鼎控股等多家行业龙头企业建立长期战略合作关系。此外，公司已进入全球头部电子材料企业供应链，成为其核心铜箔供应商。

二期项目稳步推进 高端产能逐步释放

今年1月，逸豪新材公告称，公司决定对于“年产1万吨高精度电解铜箔项目”剩余年产5500吨高精度电解铜箔预计达到可使用状态的时间延期至2026年6月。

据介绍，作为上市时的主要募投项目，截至2025年末，该项目第一期年产4500吨高精度电解铜箔已达到可使用状态，剩余年产5500吨高精度电解铜箔正在推进主要生产设备的安装、调试等相关工作。

近年来，国内电解铜箔行业整体竞争较为激烈，铜箔加工费持续处于历史低位。有铜箔行业人士认为，在行业结构性调整期，逸豪新材选择稳步推进项目建设，而非盲目上马，体现了公司对募集资金使用效率与项目质量的审慎态度，有利于规避行业产能过剩风险，实现资源的优化配置。

刘磊表示，未来随着产品研发升级迭代、产能逐步出清，行业供需关系将逐步改善。随着产能提升及品种优化，公司单面PCB产品毛利率将大幅提升。而高速铜箔等高端铜箔的需求缺口较大，这一增量市场对于铜箔企业而言，正是实现发展转型的契机。

“随着性能迭代指标趋高，越先进的产品加工费就越贵。”刘磊介绍，目前公司全系列RTP铜箔已批量供货，特殊产品RTP超厚铜箔也相继进入市场，适配高频高速应用场景的HVLIP铜箔已进入客户验证阶段。

卡位新能源赛道 协同优势打开增长空间

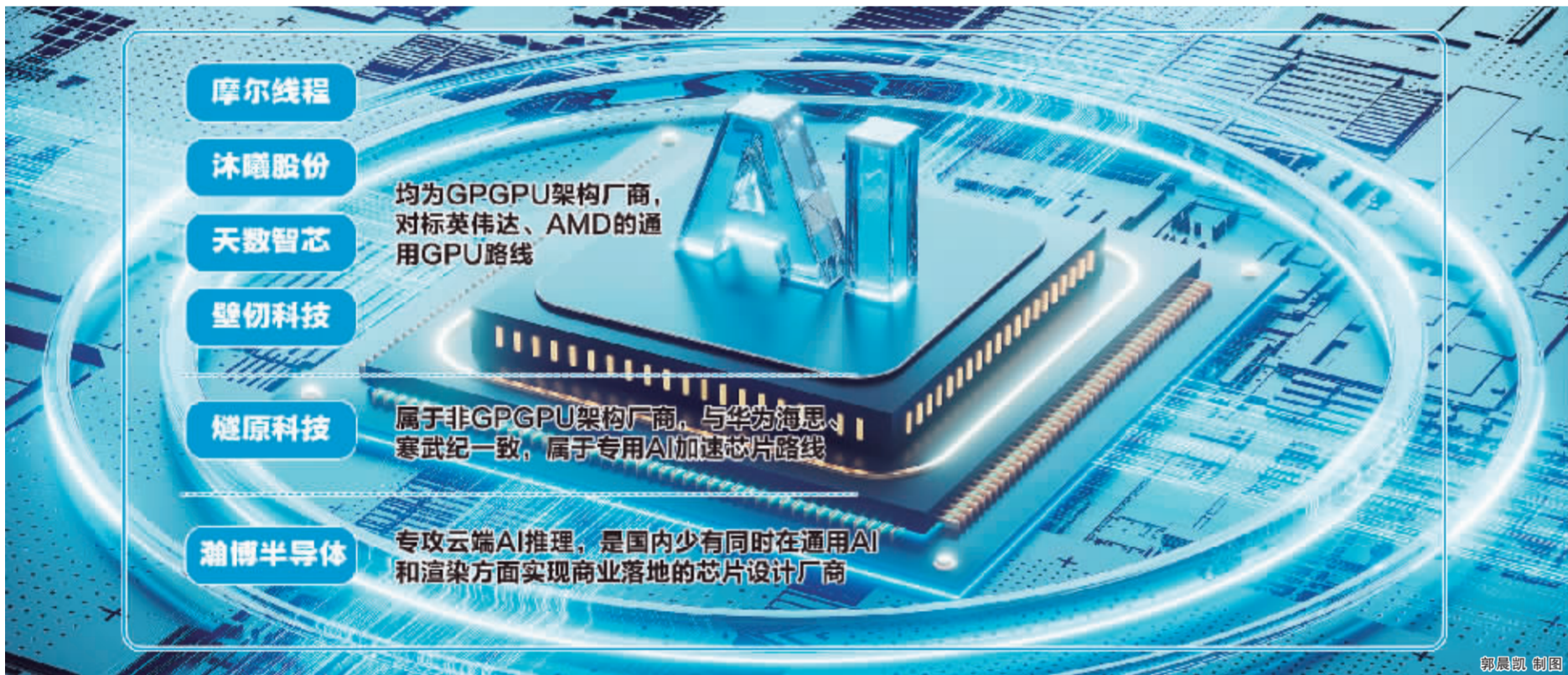
2025年铜箔行业呈现复苏回暖态势，逸豪新材业绩同步提速。2025年前三季度，公司实现营业收入12.18亿元，同比增长18.26%。其中，第三季度实现营收4.7亿元，同比增长35.09%。

业绩增长的背后，是公司依托全产业链优势的精准布局。刘磊表示，面对行业“低端过剩、高端稀缺”的格局，公司建立了高度柔性化的生产管理体系，能够快速响应下游客户在厚度、幅宽和性能等方面的多样化产品需求，有效契合铜箔订单“多规格、多批次、短交期”的特点。

铜箔市场的需求梯度在不断拓宽加深。得益于产能加码与技术创新的双轮驱动，逸豪新材已构建覆盖多场景需求的锂电铜箔产品矩阵。同时，公司对固态电池电镀镍铜箔、多孔铜箔开展研发，并掌握生产工艺。

据介绍，逸豪新材“年产1万吨高精度电解铜箔项目”的设备及工艺可实现电子电路铜箔和锂电铜箔切换生产。刘磊表示，随着该项目的稳步实施，公司将大幅提升超薄铜箔、厚铜箔及高频高速铜箔等高端产能，在新能源赛道加速卡位。

“国产AI芯片六小龙”竞速 上海助推“中国算力”破局



记者 刘怡鹤

扎根上海闵行的国产AI芯片独角兽——瀚博半导体已完成科创板上市辅导，正有序推进IPO进程；燧原科技科创板IPO申请已获受理。一旦这两家公司IPO成功，科创板就聚集了四大AI芯片新贵，加上已在港股上市的壁仞科技和天数智芯，6家各具特色的国产AI芯片“六小龙”在资本市场竞相角逐，堪称人工智能高速发展的一道亮丽风景。

上述“国产AI芯片六小龙”中，除摩尔线程外，其余5家均在上海诞生和扎根。上海成功抢抓新一轮AI革命带来的巨大机遇，在深厚的集成电路产业基础上培育出新增长极，有望进一步助推“中国AI算力”实现全球突围。

“六小龙”密集更新技术进展

研发新一代芯片是“六小龙”募资的主要用途之一。“六小龙”均属于本土云端AI芯片厂商。摩尔线程、沐曦股份、天数智芯和壁仞科技均为GPGPU架构厂商，对标英伟达、AMD的通用GPU路线。燧原科技属于非GPGPU架构厂商，与华为海思、寒武纪一致，属于专用AI加速芯片路线，类似于谷歌TPU、亚马逊Trainium。这“五小龙”主要在AI训练领域追赶海外巨头。

瀚博半导体则专攻云端AI推理，是国内少有同时在通用AI和渲染方面实现商业落地的芯片设计厂商。目前，瀚博半导体在数据中心AI领域以及边缘计算AI领域，处于国内第一梯队；在数据中心渲染领域，处于行业领先地位。公司已实现全面商业化落地和业务规模的快速增长。

近期，“六小龙”密集更新技术和产品路线。1月27日，沐曦股份推出全新GPU品牌与产品线——曦索X系列。该系列GPU专为科学智能场景深度优化，旨在以计算赋能前沿科研领域，推动传统科学计算与人工智能驱动的科研新范式融合发展。随着曦索X系列的推出，沐曦股份完成了在AI推理、AI训练、图形渲染、

科学智能四大主流算力赛道的产品矩阵全覆盖。

摩尔线程于2025年底首次公开其全功能GPU技术路线图。其新一代GPU架构“花港”基于新一代指令集，支持FP4到FP64的全精度计算，算力密度提升50%，能效提升10倍，可支持十卡以上规模智算集群。基于“花港”架构，摩尔线程公布了未来将发布的两款芯片技术路线——“华山”和“庐山”。

燧原科技招股书显示，公司成立近8年来，自研迭代了四代架构5款云端AI芯片，构建了AI芯片、AI加速卡及模组、智算系统及集群和AI计算及编程软件平台的完整产品体系，已成为我国云端AI芯片领军企业之一。本次公开发行拟募资60亿元，募集资金拟用于第五代和第六代AI芯片系列产品的研发和产业化项目、先进人工智能软硬件协同创新项目等。

瀚博半导体则依托自主原创统一计算架构VUCA、软硬件融合开发能力以及丰富的设计经验，SV和ISG两大系列AI推理和渲染芯片在国内几乎所有头部互联网公司等多家运营商实现商业化落地，广泛覆盖大模型、云渲染、智算中心、智慧工业、智慧交通等应用。

瀚博创始人兼CEO钱军认为，AI训练芯片市场固然很大，但具有更大爆发力的是云端AI推理。AI大模型应用面对的是“云端AI推理+云端渲染”产生的海量需求，这个市场不仅很大，还是蓝海。

加快沪产芯片规模化部署

集成电路是上海的传统优势产业，在世界集成电路协会《全球集成电路产业竞争力百强城市》最新排名中，上海位列全球第四、国内第一。在新一轮AI产业革命中，上海超前布局，从企业落地、人才引进到真金白银投入，将“五小龙”创新种子培育长大。

1月27日，在“算力筑基 生态赋能”主论坛上，上海市经济和信息化委员会副主任潘焱致辞时表示，面向“十五五”，上海将适度超前建设一批智算基础设施，加快沪产芯片规模化部署；构建自主可控的智算产业，

构建“国芯国模国云”体系，打响智算超节点“上海品牌”；营造开放共享的智算生态，持续优化政策、资本与人才支持，推动上海算力产业迈上新台阶。

沐曦股份创始人、董事长兼总经理陈维良表示，上海浦东始终以“功成不必在我”的战略胸怀，陪伴企业走过漫长的研发征程；以专项奖励支持，分担研发压力；以丰富的人工智能应用场景，让创新成果加速落地；用柔性的引才政策，使团队感受到“此心安处是吾乡”。

上海科创基金早在2021年6月就参与了沐曦的A轮融资，是沐曦首批国资背景股东之一。为了更好地支持沐曦发展，上海科创基金于2024年初设立专项投资基金，集合上海上国投资管、银川育成凤凰科创基金、黄浦科创集团等国资和社会资本对沐曦进行了追加投资，助力沐曦在激烈的市场竞争中站稳脚跟并逐步发展壮大。

2025年3月，上海国投先导联合领投壁仞科技，将其作为基金的首个直投项目。上海国投先导方面表示，这一决策源于对于高性能通用GPU核心技术赛道的深刻洞察：通过锚定壁仞科技的技术突破和产业化价值，助力实现全国产自主可控智能算力体系。同时，作为上海市国资背景基金，上海国投先导积极履行社会责任，支持本地“硬科技”企业高质量发展，加速构建AI产业生态。

燧原科技的2023年D轮融资金额高达20亿元，由上海国际集团旗下子公司及产业基金，包括国际资管、国鑫创投、国方创新、金浦投资旗下上海金融科技基金、国和创投联合领投。在燧原科技招股书中，仍可以看到对壁仞科技的技术突破和产业化价值，助力实现全国产自主可控智能算力体系。

瀚博半导体发展至今共获上海闵行国资、临港集团、国泰君安数亿元投资。公司同时长期受益于上海的政策扶持，经过对接上海市高质量发展专项资金、上海市服务业引导资金等政策，累计获得产业扶持资金近亿元。

上市助推“六小龙”自我成长

上市强化了AI芯片国产化趋势，不仅

为“六小龙”提供了健康稳定的资金基础，也让更多人认识到其价值。

近日，摩尔线程、沐曦股份相继发布2025年度业绩预告。摩尔线程预计2025年营收为14.50亿元至15.20亿元，同比增长230.70%至246.67%；扣非净利润亏损10.40亿元至11.50亿元，与上年同期相比，亏损收窄幅度为29.59%至36.32%。

对于此次业绩表现，摩尔线程表示，得益于人工智能产业蓬勃发展和市场对高性能GPU的强劲需求，公司以AI训练一体机智算卡MTT S5000为代表的产品竞争力优势进一步扩大，市场关注与认可度持续提升，推动收入与毛利增长，整体亏损幅度同比收窄。根据业绩预告数据，摩尔线程营业收入将连续四年保持高速增长态势，净亏损亦将连续四年实现收窄。

沐曦股份预计2025年实现营业收入16.00亿元至17.00亿元，同比增长115.32%至128.78%；归母净利润亏损6.50亿元至7.98亿元，与上年同期相比，将减少亏损6.11亿元至7.59亿元，亏损收窄43.36%至53.86%。

公告显示，2025年度，沐曦股份坚持“1+6+X”发展战略，加大市场开拓力度，不断提升公司在高性能GPU行业的市场地位和影响力，推动人工智能技术与千行百业深度融合。凭借优越的产品性能及完善的软件生态，公司产品及服务获得下游客户的广泛认可与持续采购，收入规模较上年同期实现显著增长。

上述两份业绩预告反映了国产AI芯片市场正经历的结构变革。有数据显示，国产通用GPU在国内市场占有率持续提升，市场占比由2022年的8.3%提升至2024年的17.4%，预计到2029年将超过50%。

无论是齐聚资本市场还是持续向好的业绩趋势，国产AI芯片公司正在从“多方扶持”转向“自我成长”，而“全面引领”将是下一阶段的关键跃迁。唯有真正掌握底层核心技术、深刻理解全球客户需求，并能在开放市场中持续证明商业价值，才能让“中国AI算力”成为未来全球产业链中不可或缺的组成部分。